

证券代码：605358

证券简称：立昂微

杭州立昂微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	●特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 □其他 □分析师会议 □新闻发布会 □电话会议
参与单位名称	中信证券、平安资管、聚鸣投资等 9 人
时间	2024 年 5 月 7 日 15：00
地点	现场交流
上市公司接待人员姓名	董事长：王敏文
投资者关系活动记录	投资者交流主要问题回复 1.公司二维可寻址 VCSEL 芯片的终端应用场景是哪里？ 答：立昂东芯开发的二维可寻址 VCSEL 工艺技术，目前是行业内首家、中国大陆独家量产二维可寻址激光雷达 VCSEL 芯片的制造厂商，产品终端应用于车载智能驾驶的补盲激光雷达以及人形机器人、扫地机器人等场景。 2.收购嘉兴金瑞泓少数股东权益主要考虑因素是什么？ 答：嘉兴金瑞泓已于 2024 年 12 月底建设完成第一阶段月产 15 万片的产能，目前正处于产能爬坡阶段。收购前述其他合伙人持有的嘉兴康晶的合伙企业份额可进一步增强后续运营阶段公司对于嘉兴金瑞泓的控制，增加公司在嘉兴金瑞泓享有的权益比重。 3.根据公司规模，12 英寸硅片中衢州生产重掺硅片、嘉兴生产轻掺硅片，现在嘉兴基地也需要新增外延？ 答：嘉兴金瑞泓 12 英寸硅片客户的高性能集成电路（逻辑电路芯片）也需要生长外延以改善性能，对于硅片有生长外延的需求。目前嘉兴金瑞泓硅片生长外延需求需依赖衢州金瑞泓微电子 12 英寸硅片的外延产能，有一定的运输距离和运输时间，嘉兴外延产能

	建设完成后可以缩短物流运输时间，更好的控制产品质量，更好的满足客户的需求。 4.公司 12 英寸硅片爬坡情况如何？ 答：公司 12 英寸硅片正处于产能快速爬坡阶段，2024 年公司 12 英寸硅片销售 110.30 万片，较上年同期增长 121.23%。2025 年有望继续快速爬坡。 5.公司如何看待重掺硅片的国产化趋势？ 答：公司重掺硅片产品和技术具有全球领先优势，厚外延片和低电阻率硅片属于公司的拳头产品，目前重掺片对于电阻率的要求越来越高，公司有信心承接重掺片客户的国产化需求，公司也将持续投入研发，生产优质产品。
资料清单 (如有)	无